

## 崇达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议） <span style="float: right;"> <input type="checkbox"/> 分析师会议  <input type="checkbox"/> 业绩说明会  <input type="checkbox"/> 路演活动                 </span>
参与单位名称	国信证券、交银施罗德基金等机构。 （注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。）
时间	2024年3月1日
地点	广东省深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：朱琼华
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司目前产能利用率如何？</b></p> <p>公司目前整体产能利用率80%左右，深圳工厂、江门工厂受部分订单影响，目前产能和产品交期较紧张。</p> <p><b>2、公司在手订单情况如何？</b></p> <p>公司生产经营正常，订单能见度一般在3个月左右。公司的目前在光电、汽车、手机、服务器、电脑等行业订单增速较快，其他行业整体需求变化较小。</p> <p>公司有较强的产品、成本和价格竞争力，公司发展方向在于大市场、大行业、大客户、大订单，公司将继续加大国内外客户拓展力度，加强销售团队建设，以加快新客户导入以及原有客户供应份额的提升，为快速填满新开工厂产能做好准备。</p> <p><b>3、公司崇达转2的转股价格为什么不向下修正？</b></p> <p>公司综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，于2024年2月23日召开董事会审议不向下修正“崇达转2”的转股价，同时在未来六个月内也不行使下修权利，下一触发转股价格修正条件的</p>

期间自 2024 年 8 月 24 日重新起算，若再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“崇达转 2”转股价格的向下修正权利。请关注公司后续发布的相关公告。

#### **4、珠海二期目前进展如何？**

珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为公司 2022 年非公开发行股票的募投项目，两座新厂房已封顶，主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端板产品，重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域。珠海二厂目前在加快机器设备进厂调试验收等系列工作，预计于 2024 年第一季度试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，主要应用于通讯等领域。珠海二厂的投产将为公司快速发展提供强有力的保障。

#### **5、公司目前覆铜板等原材料价格情况怎样？**

公司主要原材料包括覆铜板、铜球、半固化片和氰化金钾等；原材料受铜、石油和黄金的价格影响较大。目前公司主要原材料整体价格较去年同期有所下降，目前处于历史相对低位，近期有小幅向上波动，受市场供需影响，大幅上涨的可能性较低。

#### **6、公司 2023 年前三季度存货减值的原因？第四季度存货减值情况如何？**

公司 2023 年 1-9 月存货减值损失增加 5,434 万元，主要是市场竞争加剧，产品单价下降，基于谨慎性原则，公司按照会计准则要求计提相应存货减值，按成本与可变现净值孰低原则计提。同时考虑库存时间及影响，目前对发出商品及库存商品等库存时间超过 6 个月的，全额计提存货减值；但对中兴的这部分发出商品及库存商品，因有一定补偿等，按未能补偿损失予以计提存货减值。如未能补偿损失金额小于按成本与可变现净值孰低原则时，按成本与可变现净值孰低原则计提。后续资产减值情况详见公司发布的相关定期报告或公告。

#### **7、公司是否有在东南亚布局产能的规划？如何评估国内产业链外迁对内资产业的影响？**

公司正在做这方面的考察和评估，如有进展公司会第一时间发布相关公告。

#### **8、公司目前在服务器的生产情况和未来规划如何？**

公司 2023 年 1-9 月在服务器行业接单额同比增长 47.5%，增速较快。公司目前主要

客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley 平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代 Eagle Stream 平台以及其他 AI 服务器 PCB 产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力。

#### **9、汽车电子目前客户导入情况如何？明年汽车电子订单预期怎样？**

汽车电子方面，公司目前主要有松下（Panasonic）、普瑞均胜、泰科电子(TE Connectivity)、零跑汽车、比亚迪、LG 麦格纳（LG Magna）等客户，产品主要应用在电子驱动系统、中控系统、车身电子、通讯娱乐系统等。

公司继续通过“最好、最快、最便宜”的竞争策略，保持公司在品质、交期、价格等方面的综合竞争优势，持续为客户创造价值。2023 年 1-9 月，公司汽车电子接单额同比增长 14%，加大了原有客户的供应商份额占比并导入了新客户，根据与客户的沟通及自身汽车电子产能释放进度，预计 2024 年汽车电子订单能有较快增长。

#### **10、子公司三德冠目前业绩是否好转？**

三德冠通过积极完善生产工艺和销售渠道，与国产品牌共同发展，经营能力持续改善，目前根据客户需求持续交付应用于 Mate 系列、X5 折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品。受客户新手机、平板电脑等产品需求影响，2023 年 1-9 月收入同比增长 44.86%，月产品出货量持续提升，盈利能力持续改善。

公司会继续加大对三德冠在生产技术、管理经验、采购渠道、客户资源等方面支持，以加快三德冠经营效益的改善。

#### **11、子公司普诺威的先进封装基板进展如何？**

**关于新产能：**控股子公司普诺威专注于 BT 载板产品的研发生产，在深耕 MEMS 类载板市场的基础上，依靠多年累积的客户资源和产品经验，完成传统封装基板向先进封装基板的转型，投资 4 亿元新建了 m-SAP 制程生产线，主要聚焦于 RF 射频类封装基板、SIP 封装、电源模块管理、光通讯等细分领域市场。2022 年第四季度，SIP 封装基板事业部一期产线成功通产，二期 m-SAP 新产线已于 2023 年 9 月连线投产，目前产能正在爬坡中。针对 m-SAP 线的产品，普诺威正集中力量开发封装类半导体公司，目前已经完成华天科技、立讯精密等封装类的载板资格认证，并进入日月光半导体、诺思等供应商序

列，其他客户正在同步开发中。

关于经营情况变化：市场的需求从 2023 年 5 月份开始缓慢恢复，2023 年前三季度的净利润逐季提升，盈利能力持续改善。

珠海崇达三个工厂目前的情况详见下图：



附件清单（如有）